

ICと集積された超音波トランスデューサ

by X. Zhuang et al.

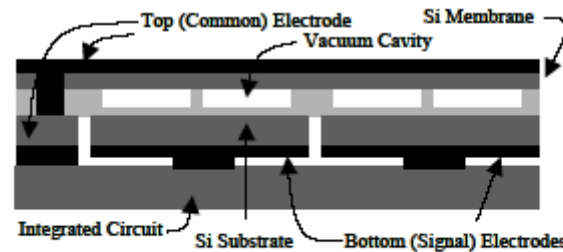


Figure 1: Cross-sectional schematic of a trench-isolated CMUT array that is flip-chip bonded to a custom-designed IC.

図1に示すように容量型マイクロマシンド超音波トランスデューサ(CMUT)アレイとカスタムICをカスタムICとフリップチップ接続で集積化した。

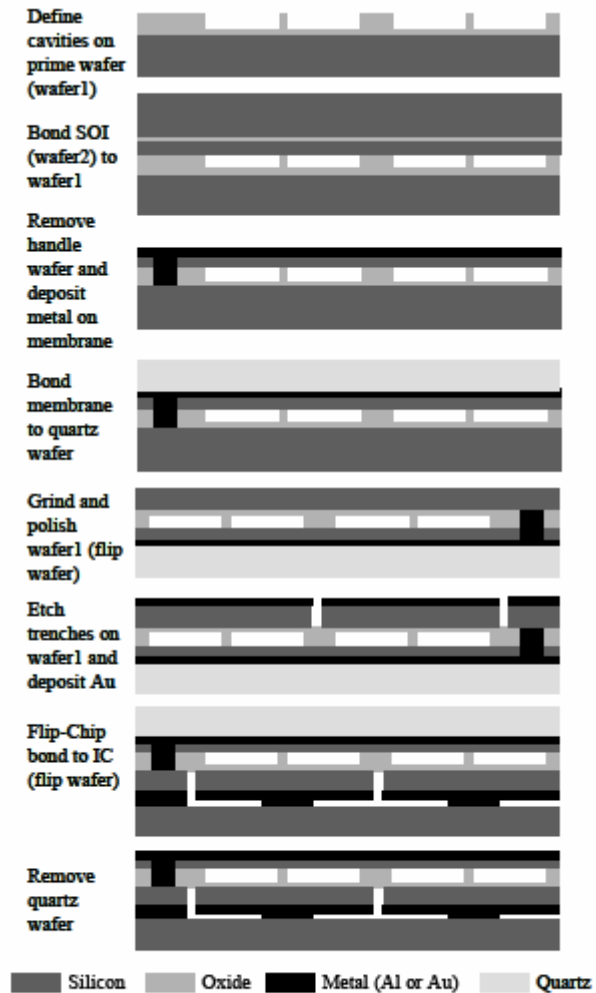


Figure 2: Fabrication steps for through-wafer trench-isolated CMUT arrays.